

<<CMOS图像传感器封装与测试技术>>

图书基本信息

书名：<<CMOS图像传感器封装与测试技术>>

13位ISBN编号：9787121028519

10位ISBN编号：7121028514

出版时间：2006-7

出版时间：电子工业出版社

作者：陈榕庭

页数：274

字数：351100

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书首先介绍整个半导体封装业的历史及演进过程，然后以光感芯片为例说明晶圆厂的芯片制造过程，光感应芯片的应用范围、结构及各种常见的CMOS模块种类等。

具体内容涉及了材料使用、设备及各工序简介、缺陷模式及热效应分析、产品可靠性的测试方法，最后阐述了目前CMOS光感测试的最新技术及多样化工序。

本书可作为微电子专业高年级本科生和研究生的教材，也可作为想从事或刚从事封装测试产业的工程师或技术人员的参考。

本书中文简体字版台湾全华科技图书股份公司独家授权，仅限于中国大陆地区出版发行，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

书籍目录

第1章 半导体封装基本知识及CMOS图像传感器的发展历史 1.1 半导体的定义 微电子工业发展 微电子材料 1.2 何谓半导体封装 1.3 现今半导体封装与图像传感器发展趋势 1.4 何谓半导体图像传感器 1.5 半导体图像传感器演变历程 1.6 CMOS传感器应用及市场规模预估 1.7 CMOS/CCD图像传感器的未来发展 参考文献第2章 半导体图像传感器封装流程 2.1 CMOS光学图像处理流程图示 2.2 CMOS图像光感应原理 2.3 半导体图像传感器——芯片制造流程 参考文献第3章 半导体图像传感器基本结构 3.1 半导体图像传感器与数码相机 3.2 半导体图像传感器封装技术的层次及功能 3.3 半导体图像传感器封装种类 3.4 CMOS图像传感器模块结构设计 参考文献第4章 半导体图像传感器封装材料简介 4.1 封装材料简介 4.2 高分子封装材料的性质 4.3 金属引线框和高分基板的受力分析 参考文献第5章 半导体图像传感器封装工艺介绍(半自动) 5.1 CMOS封装设备简介(半自动) 5.2 CMOS封装前段制作工序(1) 5.3 CMOS封装前段制作工序(2) 5.4 后段工序 参考文献第6章 半导体图像传感器封装工艺介绍(全自动) 6.1 CMOS封装工艺简介(全自动) 6.2 前段工艺(1)、(2) 6.3 前段工艺(3)、(4) 第7章 半导体图像传感器封装可靠性分析第8章 材料界面的失效分析与设计第9章 测试概论第10章 新型工艺技术第11章 半导体图像传感器相关技术名词解释附录A 常见的CMOS图像传感器各封装工序失效模式

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>